



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

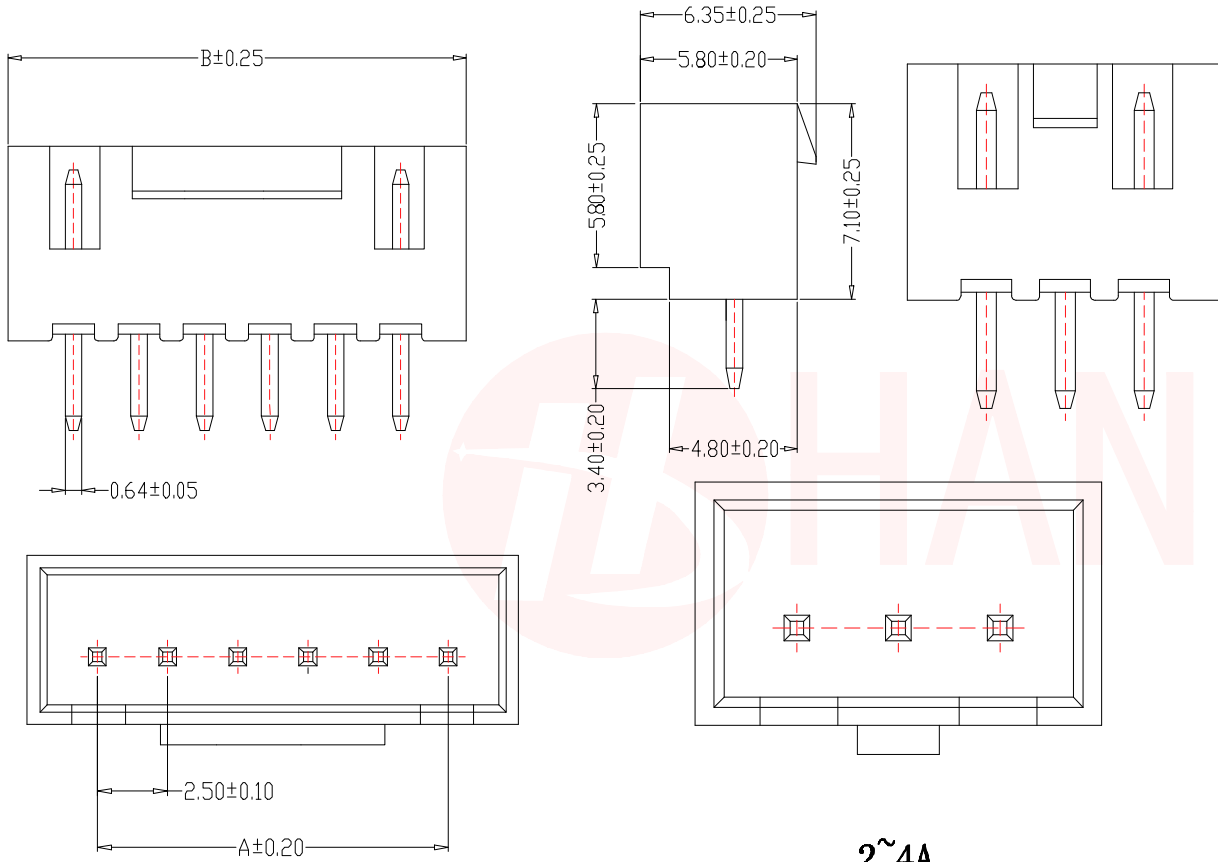
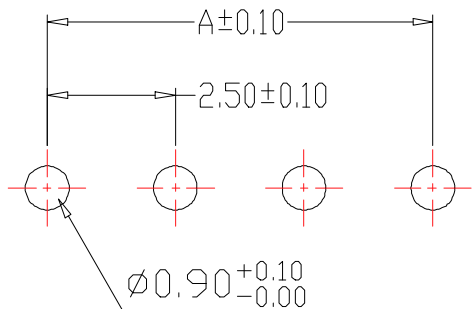


TABLE:

CSG PART NO.	Dimension mm		
	PIN	A	B
WAFER-HA254Z-2A	2P	2.50	7.50
WAFER-HA254Z-3A	3P	5.00	10.00
WAFER-HA254Z-4A	4P	7.50	12.50
WAFER-HA254Z-5A	5P	10.00	15.00
WAFER-HA254Z-6A	6P	12.50	17.50
WAFER-HA254Z-7A	7P	15.00	20.00
WAFER-HA254Z-8A	8P	17.50	22.50
WAFER-HA254Z-9A	9P	20.00	25.00
WAFER-HA254Z-10A	10P	22.50	27.50
WAFER-HA254Z-11A	11P	25.00	30.00
WAFER-HA254Z-12A	12P	27.50	32.50
WAFER-HA254Z-20A	20P	47.50	52.50



PCB LAYOUT

技术要求:

- 1、塑件材料: CM3004 (UL-94V-0)
- 2、接触件: 黄铜镀锡
- 3、接触电阻: $\leq 10m\Omega$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
- 5、额定电压: 250V AC DC
- 6、额定电流: 3.0A AC DC
- 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
- 8、工作温度: $-25^{\circ} \sim +85^{\circ}$
- 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 $220^{\circ}\pm 5^{\circ}$, 时间 2.5 ± 0.5 秒
- 10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求

序号	名称	材料	电镀 (锡): 整个表面镀底镍 30U"MIN 再镀锡80U" MIN
1	端子/Contact	黄铜	
2	基座/Wafer	LCP/PA66 (UL94V-0)	白色
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD	
DECIMALS: ANGLES:		TITLE: WAFER HA 2.54MM 直针 DIP TYPE	
X :±0.20	X :±2°	DWN	xiong PART NO. WAFER-HA254Z-NA
X.X :±0.10	X.X :±1°	CHKD	lee SCALE:1:1 UNIT: mm
X.XX :±0.05		APVD	wang SIZE: A4 SHEET:10F 1 REV: A4
CUSTOMER COPY			